

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2019年11月7日(07.11.2019)



(10) 国際公開番号

WO 2019/212008 A1

(51) 国際特許分類:

H01L 21/304 (2006.01) *C09J 11/06* (2006.01)

B32B 7/06 (2019.01) *C09J 183/05* (2006.01)

B32B 27/00 (2006.01) *C09J 183/07* (2006.01)

C09J 5/04 (2006.01) *H01L 21/02* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/017197

(22) 国際出願日: 2019年4月23日(23.04.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-088393 2018年5月1日(01.05.2018) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 澤田 和宏 (SAWADA, Kazuhiro); 〒9392753 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 森谷 俊介(MORIYA, Shunsuke); 〒9392753 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也(SHINJO, Tetsuya); 〒9392753 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究

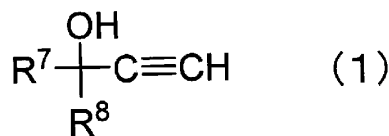
所内 Toyama (JP). 荻野 浩司(OGINO, Hiroshi); 〒9392753 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP). 奥野 貴久(OKUNO, Takahisa); 〒9392753 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社 材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所(HANABUSA PATENT & TRADEMARK OFFICE); 〒1010062 東京都千代田区神田駿河台3丁目2番地 新御茶ノ水アーバントリニティ Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: TEMPORARY ADHESIVE CONTAINING POLYSILOXANE THAT CONTAINS HEAT RESISTANT POLYMERIZATION INHIBITOR

(54) 発明の名称: 耐熱性重合禁止剤を含むポリシロキサンを含有する仮接着剤



(57) Abstract: [Problem] To provide a temporary adhesive with which no voids occur between a support body and a wafer. [Solution] This temporary adhesive, for releasably bonding a support body and a circuit surface of a wafer in order enable processing the back surface of the wafer, contains (A) a component which cures with a hydrosilylation reaction, (B) a polymerization inhibitor which has a 5% mass loss temperature in Tg-DTA of greater than or equal to 80 ° C, and (C) a solvent. The component (A) contains: a polysiloxane (A1) that contains (a1) a polyorganosiloxane containing an alkyl group of 1-10 carbon atoms and an alkenyl group of 2-10 carbon atoms, and (a2) a polyorganosiloxane containing a hydrogen atom and an alkyl group of 1-10 carbon atoms; and (A2) a platinum-group metal-base catalyst. The polymerization inhibitor (B) is a compound represented in formula (1). In formula (1), R⁷ and R⁸ are both aryl groups of 6-40 carbon atoms, or are a combination of an alkyl group of 1-10 carbon atoms and an aryl group of 6-40 carbon atoms.

[続葉有]



WO 2019/212008 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 【課題】支持体とウエハーの間にボイドの発生がない仮接着剤を提供。【解決手段】支持体とウエハーの回路面との間で剥離可能に接着しウエハーの裏面を加工するための仮接着剤であり、上記仮接着剤がヒドロシリル化反応により硬化する成分(A)とTg-DTAにおける5%質量減少温度が80℃以上である重合禁止剤(B)と溶媒(C)とを含む。成分(A)が炭素原子数1~10のアルキル基と炭素原子数2~10のアルケニル基を含むポリオルガノシロキサン(a1)と、炭素原子数1~10のアルキル基と水素原子を含むポリオルガノシロキサン(a2)とを含むポリシロキサン(A1)と、白金族金属系触媒(A2)とを含む。重合禁止剤(B)が式(1)で表される化合物である。式(1)中、R⁷及びR⁸は、いずれも炭素原子数6~40のアリール基であり、又は炭素原子数1~10のアルキル基と炭素原子数6~40のアリール基の組み合わせである。